



Tin Mate-X100A SAC305

产品规格书

标准

J-STD-005C

成分(w.%)

Ag: 3.0± 0.2 | Cu: 0.5±0.1 | Sn:余量

其他按照STD-006C杂质管控

技术性能

固相线 (°C): 217

· 液相线 (°C): 221

固相线 (°F): 423

· 液相线 (°F): 430

可制造能力

合金粉末粒径: Type3(25~45 μ m); Type4(20~38 μ m); Type5(15~25 μ m)

粘度 Viscosity: 170±30Pa·S或定制

卤素含量Halogen content: Br≤900ppm, Cl≤900ppm, Br+Cl ≤1500ppm

应用

适应多种基材的焊接: 在OSP、喷锡、ENIG上均有良好润湿;

适用于大多数PCB板SMT焊接, 空气或氮气环境。具体请参考推荐回流曲线做调整。

储存条件

保质期: 未开封, 在冷藏 (0~10°C) 条件下, 自生产日起保存6个月;

使用: 请在25±3°C的环境中使用;

回温: 请不要在冷藏环境下取出后马上使用, 至少在室温下存放4小时, 使其恢复到室温后方可使用;

使用前搅拌: 请使用锡膏搅拌机, 机器搅拌90-180 (秒) 请在开封后立即使用;